

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)

【公開番号】特開 2004-59990 (P2004-59990A)

【公開日】平成 16 年 2 月 26 日 (2004.2.26)

【年通号数】公開・登録公報 2004-008

【出願番号】特願 2002-219328 (P2002-219328)

【国際特許分類第 7 版】

C 2 3 C 14/50

C 2 3 C 16/458

C 2 3 C 16/46

// H 0 1 L 21/68

【F I】

C 2 3 C 14/50 E

C 2 3 C 14/50 F

C 2 3 C 16/458

C 2 3 C 16/46

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 29 日 (2005.7.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】成膜装置及び方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被処理基板を保持する円形のトレーと、前記トレーに対向して配置され前記被処理基板を加熱する発熱体とを有する成膜装置であって、前記トレーは外周から中心に向かって複数のスリットを有し、前記スリットを塞ぐように前記トレーと前記発熱体との間にプレートが設けられたこと

を特徴とする成膜装置。

【請求項 2】

前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴とする請求項 1 記載の成膜装置。

【請求項 3】

前記材料は C U - A Lであることを特徴とする請求項 2 に記載の成膜装置。

【請求項 4】

真空チャンバー内に配置された被処理基板を前記被処理基板に対向して設けられた発熱体で加熱しながら前記被処理基板を処理する成膜方法であって、前記真空チャンバー内に設けられたピンを突き上げることで、前記被処理基板を保持しながら前記被処理基板を処理することを特徴とする成膜方法。

【請求項 5】

前記発熱体と前記被処理基板との距離が 5 mm 以内であることを特徴とする請求項 4 記載の成膜方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成するために、請求項 1 に記載された成膜装置は、被処理基板を保持する円形のトレーと、前記トレーに対向して配置され前記被処理基板を加熱する発熱体とを有する成膜装置であって、前記トレーは外周から中心に向かって複数のスリットを有し、前記スリットを塞ぐように前記トレーと前記発熱体との間にプレートが設けられたことを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、請求項 2 に記載された成膜装置は、請求項 1 における成膜装置において、前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴する。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

また、請求項 3 に記載された成膜装置は、請求項 2 における成膜装置において、記材料は C U - A L であることを特徴とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

また、請求 4 に記載された成膜方法は、真空チャンバー内に配置された被処理基板を前記被処理基板に対向して設けられた発熱体で加熱しながら前記被処理基板を処理する成膜方法であって、前記真空チャンバー内に設けられたピンを突き上げることで、前記被処理基板を保持しながら前記被処理基板を処理することを特徴とする。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

更に、請求 5 に記載された成膜方法は、請求項 4 における成膜方法において、前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴とす

る。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】削除

【補正の内容】